

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2026-010

常州中英科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中英科技	股票代码	300936
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞丞	吴英	
办公地址	常州市钟楼区正强路 28 号	常州市钟楼区正强路 28 号	
传真	0519-83252250	0519-83252250	
电话	0519-83253332	0519-83253330	
电子信箱	czzyst2016@163.com	ZYST@czzyst.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

中英科技聚焦于通信领域，致力于为下游客户提供具备高性能、多样化、高良率的产品，目前产品以高频通信材料为核心。其下游应用领域集中在通信基站与手机等散热领域。孙公司赛肯徐州主要产品为引线框架，应用于半导体封测领域。

1、通信材料相关行业的发展

(1) 高频覆铜板细分行业

覆铜板作为印制电路板的核心基材，其终端应用涵盖通信、消费电子、汽车电子及军事航空等多个领域。该行业历经三次重大技术迭代升级：第一轮由环保要求驱动的“无铅无卤化”转型已全面完成；第二轮基于电路集成度提升与智能终端小型化需求的“轻薄化”技术革新已实现行业普及；第三轮由 5G 通信技术升级推动的“高频高速化”变革正处于快速发展阶段。

据中国台湾电路板协会 TPCA 预估，2025 年全球 PCB 产值将达 923.6 亿美元，年成长率高达 15.4%，2026 年产值有望进一步攀升至 1052 亿美元，年增 13.9%。TPCA 预估，2026 年全球 PCB 产值可望进一步攀升至 1052 亿美元，年增 13.9%，显示 AI 正成为驱动产业升级与价值重构的关键引擎。

根据工信部发布的数据，5G 网络建设正稳步推进。截至 2025 年底，全国移动电话基站总数达 1287 万个，比上年末净增 22.7 万个。其中，4G 基站为 719.2 万个，比上年末净增 8 万个；5G 基站为 483.8 万个，比上年末净增 58.8 万个。5G 基站占移动电话基站总数达 37.6%，占比较上年末提升 4 个百分点。

全国 300 多个城市启动 5G-A 网络建设。目前我国一些地区的 5G 信号覆盖率以及 5G 网速仍有较大提升空间，仍需要加深推进 5G 网络覆盖面的建设，将继续带动通信基站领域对于高频 PCB 和高频覆铜板的需求。

随着通信、算力等需求的不断提升，下游客户对于高频高速材料的需求也持续扩大，为高频、高速覆铜板打开了新的市场空间。为进一步契合下游客户需求及市场发展趋势、丰富产品应用场景，公司正持续推进高速覆铜板的研发与试制，截至本报告出具之日，该类产品处于研发测试中，尚未计入量产阶段。

(2) 手机散热领域行业

根据 IDC 的统计数据，全球智能手机在 2013 年首次突破 10 亿台，2014 年至 2021 年，出货量均保持在较高水平。未来，随着 5G 网络的普及，以及智能手机大屏化、高性能化、折叠化的应用，全球智能手机换机潮仍然可期。根据 IDC 最新发布的《全球季度手机跟踪报告》初步数据，2025 年全球智能手机出货量达到 12.6 亿部，同比增长 1.9%。IDC 指出，在关税波动、供应链扰动及宏观经济压力下，这一增长体现了市场的韧性。

根据 Canalys 的统计数据，在产品升级迭代和智能化功能需求不断提升的推动下，AI 手机，Canalys 预计，AI 手机市场在 2023 年至 2028 年间预计以 63% 的年均复合增长率增长。

公司的 VC 散热片是生产 VC 均热板的重要原材料。近年来，随着智能手机性能及功耗的增加，以及 VC 均热板生产工艺的不断成熟，VC 均热板在智能手机领域的渗透率持续提升，已逐步发展成为中高端智能手机的主流散热解决方案。未来，随着手机产品的性能要求越来越高，内部元器件不断朝着集成化、轻量化方向发展，将进一步带动对于手机热管理器件与散热材料的需求升级。

2、半导体封装材料行业

赛肯徐州的主要产品为引线框架，引线框架为半导体封装材料。

目前全球半导体产业链持续向中国大陆迁移，为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，近些年来，中央及地方政府推出了一系列鼓励和支持半导体产业发展的政策。

引线框架作为封装材料中仅次于封装基板的第二大封装材料，随着新能源汽车、物联网等新兴产业的快速发展，同时集成电路封装向高集成、高性能、多引线、窄间距为特征的高密度方向发展，刻蚀类引线框架市场需求也呈现出持续增长趋势。根据 QYResearch 调研，预计至 2029 年，全球引线框架市场规模将达到 51.8 亿美元。从 2023 年至 2029 年，该市场的年复合增长率（CAGR）预计为 3.8%。

3、其他少量业务所在行业

(1) 储能行业

公司子公司嘉森能源，从事储能行业的集成业务，为客户提供储能直流侧部分设备的集成服务。该业务目前处于起步阶段，暂未形成持续利润贡献的能力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	1,143,398,543.82	1,104,966,462.15	3.48%	1,101,422,637.52
归属于上市公司股东的净资产	1,009,079,655.30	1,014,474,306.23	-0.53%	1,035,476,115.99
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	226,131,522.42	275,377,740.70	-17.88%	278,044,367.43
归属于上市公司股东的净利润	2,125,349.07	31,638,190.24	-93.28%	146,012,383.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,023,520.10	19,145,485.04	-136.68%	27,727,231.02
经营活动产生的现金流量净额	7,202,370.64	20,681,723.63	-65.18%	32,185,554.54
基本每股收益（元/股）	0.0283	0.4207	-93.27%	1.9417
稀释每股收益（元/股）	0.0283	0.4207	-93.27%	1.9417
加权平均净资产收益率	0.21%	3.10%	-2.89%	15.17%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	41,078,674.93	56,138,933.95	60,052,106.01	68,861,807.53
归属于上市公司股东的净利润	143,243.60	-8,097,871.95	767,706.56	9,312,270.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,426,806.08	-8,330,838.73	113,325.63	2,620,799.08
经营活动产生的现金流量净额	2,894,754.71	-9,264,894.65	12,993,085.90	579,424.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,917	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---	--------------------	---

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
俞卫忠	境内自然人	23.57%	17,727,600.00	13,295,700.00	不适用	0.00
俞丞	境内自然人	17.44%	13,113,200.00	9,834,900.00	不适用	0.00
戴丽芳	境内自然人	7.86%	5,909,200.00	4,431,900.00	不适用	0.00
常州市中英管道有限公司	境内非国有法人	5.98%	4,500,000.00	0.00	不适用	0.00
常州中英汇才股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.11%	2,337,800.00	0.00	不适用	0.00
高君	境内自然人	0.84%	632,900.00	0.00	不适用	0.00
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	534,958.00	0.00	不适用	0.00
马龙秀	境内自然人	0.71%	532,200.00	0.00	不适用	0.00
黄秀卿	境内自然人	0.65%	492,300.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.52%	387,500.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制中英管道。俞卫忠为公司员工持股平台中英汇才的普通合伙人。马龙秀与公司控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳和俞丞签订《一致行动协议书》为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

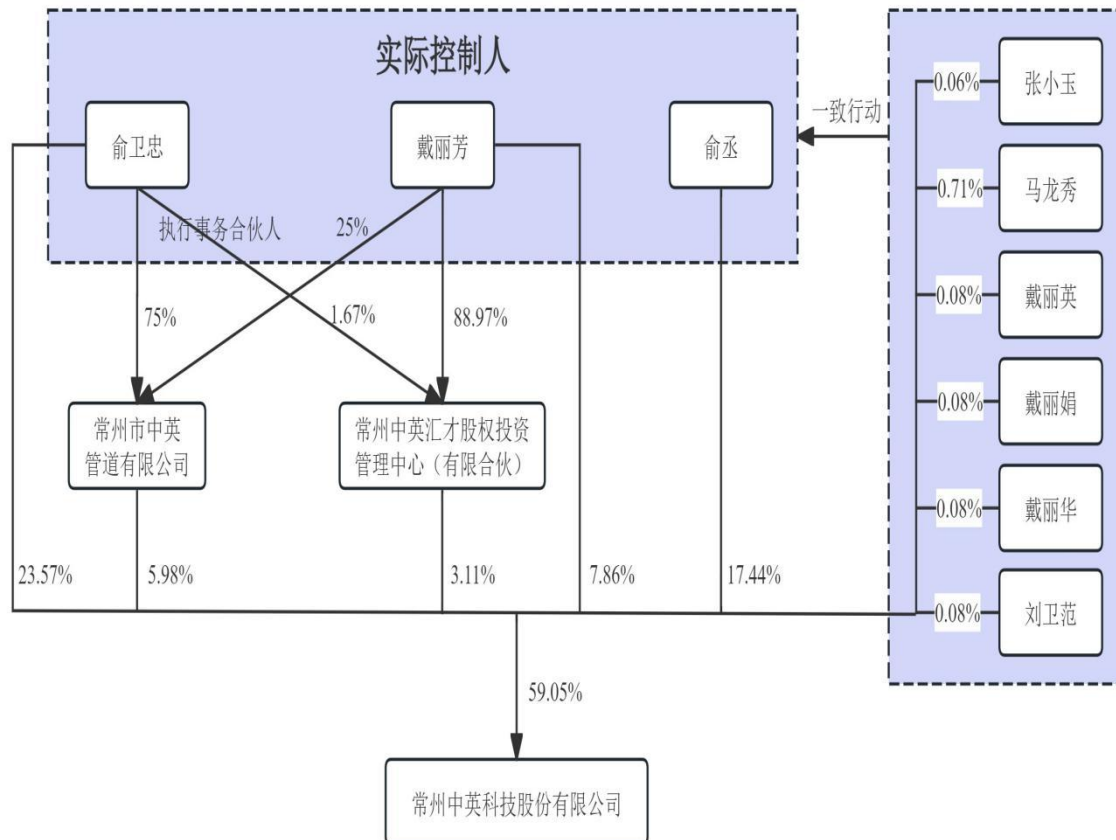
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动

为进一步规范管理公司部分股东所持股份的变动，公司控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳、俞丞与股东张小玉、马龙秀、戴丽英、戴丽娟、戴丽华、刘卫范签订《一致行动协议书》，并将上述股东作为控股股东、实际控制人的一致行动人进行管理。签署一致行动协议后，控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳和俞丞及其一致行动人合计持股比例由 62.89% 增加至 64.04%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。具体内容，详见公司 2024 年 3 月 8 日披露的相关公告。

中英汇才于 2024 年 10 月减持 609,000 股，故上述股东合计持股比例由 64.04% 下降至 63.23%，详见公司 2024 年 11 月 29 日披露的相关公告。

中英管道于 2025 年 7 月 1 日通过询价转让累计减持公司股份 3,000,000 股，故上述股东合计持股比例由 63.23% 下降至 59.24%，详见公司 2025 年 7 月 2 日披露的相关公告。

中英汇才于 2025 年 8 月减持 98,200 股，故上述股东合计持股比例由 59.24% 下降至 59.11%，详见公司 2025 年 11 月 5 日披露的相关公告。

马龙秀于 2025 年 12 月减持 47,800 股，故上述股东合计持股比例由 59.11% 下降至 59.05%，详见公司 2026 年 1 月 15 日披露的相关公告。